

香港交易及结算有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二四年第三季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2024年11月7日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二四年九月三十日止三个月的综合经营业绩。

二零二四年第三季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入 5.263 亿美元，同比下降 7.4%，环比增长 10.0%。
- 毛利率 12.2%，同比下降 3.9 个百分点，环比上升 1.7 个百分点。
- 母公司拥有人应占溢利 4,480 万美元，同比上升 222.6%，环比上升 571.6%。
- 基本每股盈利 0.026 美元，同比上升 188.9%，环比上升 550.0%。
- 净资产收益率（年化）2.8%，同比上升 1.6 个百分点，环比上升 2.4 个百分点。

二零二四年第四季度指引

- 我们预计销售收入约在 5.3 亿美元至 5.4 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 11%至 13%之间。

总裁致辞

公司总裁兼执行董事唐均君先生对 2024 年第三季度业绩评论道：

“半导体市场的整体复苏态势比较符合我们的预期，但存在着结构性的分化。消费电子及部分新兴应用等领域的需求向好，功率半导体等需求情况的改善仍有待观察。2024 年第三季度，华虹半导体的销售收入达到 5.263 亿美元、毛利率为 12.2%，均优于指引，并均实现了环比提升。产能利用率也达到了全方位满产。多元化的产品结构及营运效率的优化，展现出公司在面对复杂市场环境时拥有较好的韧性。”

唐总继续表示：“无锡新 12 英寸产线的建设持续按计划推进，预计各工艺平台的试生产及工艺验证将在今年年底到明年年初全面铺开。我们将利用新生产线进行工艺平台的持续技术迭代，以满足下游各类新兴需求的不断涌现与增长，带动公司整体营运表现迈上新台阶。”

电话会议公告

日期 2024 年 11 月 7 日，星期四

时间： 17:00 香港/上海时间

04:00 美国东部时间

发言人： 唐均君，总裁兼执行董事
王鼎，执行副总裁兼首席财务官

网上会议： 会议将在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/c3dkanog> 作在线直播

(请提前注册登记)

电话会议： 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN (个人身份识别码)。

<https://register.vevent.com/register/BI64f699022e5246a4952424f5bd0c3548>

重要提示：在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。

网上回放： 直播约 2 小时后，您可在 12 个月内在以下网页重复收听会议。

https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司 (A 股简称: 华虹公司, 688347; 港股简称: 华虹半导体, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + Power Discrete”的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等“8 英寸 + 12 英寸”特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有“8 英寸 + 12 英寸”先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 月产能约 18 万片。另在无锡高新技术产业开发区内建有一座月产能 9.45 万片的 12 英寸晶圆厂 (“华虹无锡”), 这不仅是全球领先的 12 英寸特色工艺生产线, 也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。目前, 本公司正在推进华虹无锡二期 12 英寸芯片生产线 (“华虹制造”) 的建设。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	526,306	568,529	478,524	(7.4)%	10.0 %
毛利	64,007	91,623	50,063	(30.1)%	27.9 %
毛利率	12.2 %	16.1 %	10.5 %	(3.9)	1.7
经营开支	(81,430)	(85,065)	(90,328)	(4.3)%	(9.9)%
其他收入/(损失)净额	51,797	(19,417)	6,885	(366.8)%	652.3 %
税前溢利/(损失)	34,374	(12,859)	(33,380)	(367.3)%	(203.0)%
所得税开支	(11,461)	(12,999)	(8,368)	(11.8)%	37.0 %
期内溢利/(损失)	22,913	(25,858)	(41,748)	(188.6)%	(154.9)%
净利润率	4.4 %	(4.5)%	(8.7)%	8.9	13.1
以下各方应占利润:					
母公司拥有人	44,816	13,890	6,673	222.6 %	571.6 %
非控股权益	(21,903)	(39,748)	(48,421)	(44.9)%	(54.8)%
持有人应占每股盈利					
基本	0.026	0.009	0.004	188.9 %	550.0 %
摊薄	0.026	0.009	0.004	188.9 %	550.0 %
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,200	1,077	1,106	11.4 %	8.5 %
产能利用率 ¹	105.3 %	86.8 %	97.9 %	18.5	7.4
净资产收益率 ²	2.8 %	1.2 %	0.4 %	1.6	2.4

二零二四年第三季度

- 销售收入 5.263 亿美元, 同比下降 7.4%, 主要由于平均销售价格下降, 部分被付运晶圆数量上升所抵消, 环比增长 10.0%, 主要由于付运晶圆数量上升。
- 毛利率 12.2%, 同比下降 3.9 个百分点, 主要由于平均销售价格下降, 部分被产能利用率提升所抵消, 环比上升 1.7 个百分点, 主要由于产能利用率提升。
- 经营开支 8,140 万美元, 同比和环比分别下降 4.3%和 9.9%, 主要由于研发工程片开支下降。
- 其他收入净额 5,180 万美元, 上年同期为其他损失净额 1,940 万美元, 上季度为其他收入净额 690 万美元, 主要由于本季度为外币汇兑收益, 而上年同期及上季度为外币汇兑损失, 以及本季度政府补贴上升。
- 所得税开支 1,150 万美元, 同比下降 11.8%, 环比上升 37.0%。
- 期内溢利 2,290 万美元, 上年同期为期内损失 2,590 万美元, 上季度为期内损失 4,170 万美元。
- 母公司拥有人应占溢利 4,480 万美元, 同比上升 222.6%, 环比上升 571.6%。
- 基本每股盈利 0.026 美元, 同比上升 188.9%, 环比上升 550.0%。
- 净资产收益率(年化) 2.8%, 同比上升 1.6 个百分点, 环比上升 2.4 个百分点。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	497,847	94.6 %	538,547	94.7 %	(40,700)	(7.6)%
其他	28,459	5.4 %	29,982	5.3 %	(1,523)	(5.1)%
销售收入总额	526,306	100.0 %	568,529	100.0 %	(42,223)	(7.4)%

- 本季度 94.6%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	263,139	50.0 %	298,615	52.5 %	(35,476)	(11.9)%
12 吋晶圆	263,167	50.0 %	269,914	47.5 %	(6,747)	(2.5)%
销售收入总额	526,306	100.0 %	568,529	100.0 %	(42,223)	(7.4)%

- 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入各贡献了销售收入总额的 50%。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二四年 第三季度 千美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	二零二三年 第三季度 千美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	434,532	82.5 %	441,246	77.5 %	(6,714)	(1.5)%
北美 ⁴	46,709	8.9 %	48,764	8.6 %	(2,055)	(4.2)%
亚洲 ⁵	27,829	5.3 %	34,663	6.1 %	(6,834)	(19.7)%
欧洲	16,358	3.1 %	38,976	6.9 %	(22,618)	(58.0)%
日本 ⁶	878	0.2 %	4,880	0.9 %	(4,002)	(82.0)%
銷售收入總額	526,306	100.0 %	568,529	100.0 %	(42,223)	(7.4)%

- 本季度来自于中国的销售收入 4.345 亿美元，占销售收入总额的 82.5%，同比下降 1.5%，主要由于 IGBT、超级结和闪存产品的需求及平均销售价格下降，部分被 CIS 及其他电源管理的产品需求增加所抵消。
- 本季度来自于北美的销售收入 4,670 万美元，同比下降 4.2%，主要由于 MCU、通用 MOSFET、逻辑、及超级结产品的需求下降，部分被其他电源管理产品的需求增加所抵消。
- 本季度来自于亚洲的销售收入 2,780 万美元，同比下降 19.7%，主要由于逻辑、超级结及通用 MOSFET 产品的需求下降。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 1,640 万美元，同比下降 58.0%，主要由于智能卡芯片、IGBT 及通用 MOSFET 产品的需求下降。
- 本季度来自于日本的销售收入 90 万美元，同比下降 82.0%，主要由于超级结、MCU 及逻辑产品的需求下降。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二四年	二零二四年	二零二三年	二零二三年	同比	同比
	第三季度	第三季度	第三季度	第三季度		
	千美元	%	千美元	%	千美元	%
	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)		
嵌入式非易失性存储器	132,598	25.2 %	143,629	25.3 %	(11,031)	(7.7)%
独立式非易失性存储器	29,334	5.6 %	36,800	6.5 %	(7,466)	(20.3)%
分立器件	163,253	31.1 %	235,978	41.5 %	(72,725)	(30.8)%
逻辑及射频	77,010	14.6 %	49,878	8.8 %	27,132	54.4 %
模拟与电源管理	122,850	23.3 %	100,897	17.7 %	21,953	21.8 %
其他	1,261	0.2 %	1,347	0.2 %	(86)	(6.4)%
销售收入总额	526,306	100.0 %	568,529	100.0 %	(42,223)	(7.4)%

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.326 亿美元，同比下降 7.7%，主要由于智能卡芯片的需求下降。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 2,930 万美元，同比下降 20.3%，主要由于闪存产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度分立器件销售收入 1.633 亿美元，同比下降 30.8%，主要由于 IGBT 及超级结产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度逻辑及射频销售收入 7,700 万美元，同比增长 54.4%，主要得益于 CIS 及逻辑产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.229 亿美元，同比增长 21.8%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的 销售收入	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
55nm 及 65nm	116,596	22.2 %	87,329	15.4 %	29,267	33.5 %
90nm 及 95nm	98,966	18.8 %	87,616	15.4 %	11,350	13.0 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	68,274	13.0 %	82,990	14.6 %	(14,716)	(17.7)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	37,894	7.2 %	34,993	6.2 %	2,901	8.3 %
0.25 μ m	4,155	0.8 %	8,395	1.5 %	(4,240)	(50.5)%
0.35 μ m 及以上	200,421	38.0 %	267,206	46.9 %	(66,785)	(25.0)%
销售收入总额	526,306	100.0 %	568,529	100.0 %	(42,223)	(7.4)%

- 本季度 55nm 及 65nm 工艺技术节点的销售收入 1.166 亿美元，同比增长 33.5%，主要得益于 CIS 及其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 9,900 万美元，同比增长 13.0%，主要得益于 MCU 及其他电源管理产品的需求增加，部分被智能卡芯片的需求下降所抵消。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工艺技术节点的销售收入 6,830 万美元，同比下降 17.7%，主要由于 MCU 产品的平均销售价格及智能卡芯片的需求下降。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工艺技术节点的销售收入 3,790 万美元，同比增长 8.3%，主要得益于逻辑及其他电源管理产品的需求增加，部分被模拟产品的需求下降所抵消。
- 本季度 0.25 μ m 工艺技术节点的销售收入 420 万美元，同比下降 50.5%，主要由于 RF 产品的需求下降。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工艺技术节点的销售收入 2.004 亿美元，同比下降 25.0%，主要由于 IGBT 及超级结产品的需求及平均销售价格下降。

销售收入分析

按终端市场分布划分的 销售收入	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
电子消费品	330,928	62.9 %	325,224	57.2 %	5,704	1.8 %
工业及汽车	123,853	23.5 %	159,380	28.0 %	(35,527)	(22.3)%
通讯	65,952	12.5 %	71,662	12.6 %	(5,710)	(8.0)%
计算器	5,573	1.1 %	12,263	2.2 %	(6,690)	(54.6)%
销售收入总额	526,306	100.0 %	568,529	100.0 %	(42,223)	(7.4)%

- 本季度电子消费品作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 3.309 亿美元，占销售收入总额的 62.9%，同比增长 1.8%，主要得益于其他电源管理的需求增加，部分被超级结和闪存产品的平均销售价格及需求下降所抵消。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.239 亿美元，同比下降 22.3%，主要由于 IGBT 产品的平均销售价格及需求下降，部分被其他电源管理产品的需求增加所抵消。
- 本季度通讯产品销售收入 6,600 万美元，同比下降 8.0%，主要由于智能卡芯片及模拟产品的需求下降，部分被 CIS 产品需求增加所抵消。
- 本季度计算器产品销售收入 560 万美元，同比下降 54.6%，主要由于通用 MOSFET 及超级结产品的需求下降。

产能⁷及产能利用率

晶圆厂(折合千片晶圆)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)
产能 (200mm)	178	178	178
产能 (300mm)	95	80	95
合计产能(折合 8 吋千片晶圆)	391	358	391
产能利用率 (200mm)	113.0%	95.3%	107.6%
产能利用率 (300mm)	98.5%	78.4%	89.3%
总体产能利用率	105.3%	86.8%	97.9%

- 本季度末月产能 391,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 105.3%，较上季度上升 7.4 个百分点。

⁷ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,200	1,077	1,106	11.4 %	8.5 %

- 本季度付运晶圆 1,200,000 片，同比上升 11.4%，环比上升 8.5%。

经营开支分析

以千美元计	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,241	2,415	2,785	(7.2)%	(19.5)%
管理费用 ⁸	79,189	82,650	87,543	(4.2)%	(9.5)%
经营开支	81,430	85,065	90,328	(4.3)%	(9.9)%

- 经营开支 8,140 万美元，同比和环比分别下降 4.3%和 9.9%，主要由于研发工程片开支下降。

其他收入/(损失)净额

以千美元计	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,612	3,428	3,558	5.4 %	1.5 %
利息收入	26,710	15,742	29,787	69.7 %	(10.3)%
汇兑收益/(损失)	29,270	(13,986)	(7,921)	(309.3)%	(469.5)%
分占联营公司溢利/(损失)	1,087	(1,410)	1,394	(177.1)%	(22.0)%
财务费用	(27,275)	(24,257)	(24,847)	12.4 %	9.8 %
政府补贴	18,535	77	4,778	23,971.4 %	287.9 %
其他	(142)	989	136	(114.4)%	(204.4)%
其他收入/(损失)净额	51,797	(19,417)	6,885	(366.8)%	652.3 %

- 其他收入净额 5,180 万美元，上年同期为其他损失净额 1,940 万美元，上季度为其他收入净额 690 万美元，主要由于本季度为外币汇兑收益，而上年同期及上季度为外币汇兑损失，以及本季度政府补贴上升。

⁸管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所(用)/得现金流量净额	(26,838)	152,091	96,890	(117.6)%	(127.7)%
投资活动所用现金流量净额	(715,920)	(177,466)	(171,973)	303.4 %	316.3 %
融资活动所(用)/得现金流量净额	(5,007)	3,176,383	416,148	(100.2)%	(101.2)%
外汇汇率变动影响净额	90,648	(12,464)	(25,185)	(827.3)%	(459.9)%
现金及现金等价物变动影响净额	(657,117)	3,138,544	315,880	(120.9)%	(308.0)%

- 本季度经营活动所用现金流量净额 2,680 万美元，上年同期及上季度分别为经营活动所得现金流量 1.521 亿美元及 9,690 万美元，主要由于本季度支付的进口增值税增加，部分被收到政府补贴上升所抵消。
- 投资活动所用现金流量净额 7.159 亿美元，其中包括固定资产投资支出 7.340 亿美元，部分被收到利息收入 1,810 万美元所抵消。
- 融资活动所用现金流量净额 500 万美元，其中偿还银行借款本金 450 万美元，支付利息 330 万美元，及支付租赁负债 100 万美元，部分被提取银行借款 230 万美元，及员工行权发行股份收到 150 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)
资产总额	13,082,459	12,104,780
负债总额	3,867,040	3,059,884
所有者权益总额	9,215,419	9,044,896
资产负债率 ⁹	29.6%	25.3%

资本开支

以千美元计	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)
华虹 8 吋	28,607	27,997
华虹无锡	87,754	40,431
华虹制造	617,708	128,402
合计	734,069	196,830

- 本季度资本开支 7.340 亿美元，其中 6.177 亿美元用于华虹制造，8,780 万美元用于华虹无锡，及 2,860 万美元用于华虹 8 吋。

⁹资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)
发展中物业	225,711	207,151
存货	487,480	462,563
贸易应收款项及应收票据	268,186	274,382
预付款项、其他应收款项及其他资产	269,191	75,761
应收关联方款项	25,426	16,034
已冻结存款及定期存款	32,443	39,259
现金及现金等价物	5,766,749	6,423,866
流动资产总额	7,075,186	7,499,016
贸易应付款项	273,352	246,206
其他应付款项及暂估费用	1,237,992	505,945
计息银行借款	262,296	247,034
租赁负债	4,451	4,674
政府补助	40,072	39,359
应付关联方款项	10,167	8,340
应付所得税	26,494	19,038
流动负债总额	1,854,824	1,070,596
净营运资金	5,220,362	6,428,420
速动比率	3.4x	6.4x
流动比率	3.8x	7.0x
贸易应收款项及应收票据周转天数	47	55
存货周转天数	92	94

- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 7,580 万美元上升至本季度末的 2.692 亿美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 应收关联方款项由上季度末的 1,600 万美元上升至本季度末的 2,540 万美元，主要由于应收一家关联方的租赁款增加。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 5.059 亿美元上升至本季度末的 12.380 亿美元，主要由于应付资本开支增加。
- 应付关联方款项由上季度末的 830 万上升至本季度末的 1,020 万美元，主要由于应付关联方的贸易款项上升。
- 应付所得税由上季度末的 1,900 万美元上升至本季度末的 2,650 万美元，主要由于本季度计提所得税开支。
- 净营运资金 本季度末 52.204 亿美元，流动比率 3.8。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 47 天。
- 存货周转天数 92 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)
销售收入	526,306	568,529	478,524
销售成本	(462,299)	(476,906)	(428,461)
毛利	64,007	91,623	50,063
其他收入及收益	78,092	20,290	38,259
销售及分销费用	(2,241)	(2,415)	(2,785)
管理费用	(79,189)	(82,650)	(87,543)
其他费用	(107)	(14,040)	(7,921)
财务费用	(27,275)	(24,257)	(24,847)
分占联营公司溢利/(损失)	1,087	(1,410)	1,394
税前溢利/(损失)	34,374	(12,859)	(33,380)
所得税开支	(11,461)	(12,999)	(8,368)
期内溢利/(损失)	22,913	(25,858)	(41,748)
以下各方应占利润			
母公司拥有人	44,816	13,890	6,673
非控股权益	(21,903)	(39,748)	(48,421)
持有人应占每股盈利			
基本	0.026	0.009	0.004
摊薄	0.026	0.009	0.004
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,717,612,830	1,580,159,540	1,716,917,408
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,721,402,553	1,587,083,357	1,720,532,998

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	5,198,989	3,750,176	3,322,946
投资物业	168,433	165,611	164,287
使用权资产	81,372	80,629	79,070
无形资产	38,897	42,320	29,182
于联营公司的投资	144,534	141,036	128,833
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	290,857	285,938	153,024
长期预付款项	83,396	139,425	36,085
递延税项资产	795	629	17,217
非流动资产总额	6,007,273	4,605,764	3,930,644
流动资产			
发展中物业	225,711	207,151	157,230
存货	487,480	462,563	492,783
贸易应收款项及应收票据	268,186	274,382	318,787
预付款项、其他应收款项及其他资产	269,191	75,761	34,168
应收关联方款项	25,426	16,034	19,572
已冻结存款及定期存款	32,443	39,259	31,654
现金及现金等价物	5,766,749	6,423,866	4,989,501
流动资产总额	7,075,186	7,499,016	6,043,695
流动负债			
贸易应付款项	273,352	246,206	213,530
其他应付款项及暂估费用	1,237,992	505,945	357,181
计息银行借款	262,296	247,034	180,238
租赁负债	4,451	4,674	3,281
政府补助	40,072	39,359	34,321
应付关联方款项	10,167	8,340	4,604
应付所得税	26,494	19,038	57,885
流动负债总额	1,854,824	1,070,596	851,040
流动资产净额	5,220,362	6,428,420	5,192,655
总资产减流动负债	11,227,635	11,034,184	9,123,299
非流动负债			
计息银行借款	1,983,494	1,964,956	1,745,779
租赁负债	19,334	19,440	18,650
递延税项负债	9,388	4,892	26,625
非流动负债总额	2,012,216	1,989,288	1,791,054
净资产	9,215,419	9,044,896	7,332,245
权益和负债权益			
股本	4,936,472	4,935,470	4,932,673
储备	1,478,303	1,333,799	1,164,151
本公司拥有人应占权益	6,414,775	6,269,269	6,096,824
非控股权益	2,800,644	2,775,627	1,235,421
权益总额	9,215,419	9,044,896	7,332,245

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于九月三十日	于九月三十日	于六月三十日
	二零二四年 (未经审核)	二零二三年 (未经审核)	二零二四年 (未经审核)
经营活动现金流量：			
税前溢利/(亏损)	34,374	(12,859)	(33,380)
折旧及摊销	143,557	127,305	136,881
应占联营公司(溢利)/损失	(1,087)	1,410	(1,394)
营运资金的变动及其它	(203,682)	36,235	(5,217)
经营活动所(用)/得现金流量净额	(26,838)	152,091	96,890
投资活动现金流量：			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(734,069)	(193,652)	(196,830)
其他投资活动所得现金流量	18,149	16,186	24,857
投资活动所用现金流量净额	(715,920)	(177,466)	(171,973)
融资活动现金流量：			
非控股权益资本注资	-	-	492,450
提取银行贷款	2,287	347,707	99,042
发行股份所得收益	1,471	2,937,689	579
偿还银行贷款	(4,476)	(239,086)	(87,530)
已付利息	(3,283)	(3,803)	(49,800)
向股东支付股息	(7,371)	-	(28,876)
已抵押存款减少/(增加)	7,369	136,524	(7,369)
支付租赁负债	(1,004)	(1,230)	(2,348)
其他融资活动所用现金流量	-	(1,418)	-
融资活动所(用)/得现金流量净额	(5,007)	3,176,383	416,148
现金及现金等价物(减少)/增加净额	(747,765)	3,151,008	341,065
外汇汇率变动影响净额	90,648	(12,464)	(25,185)
期初现金及现金等价物	6,423,866	1,850,957	6,107,986
期末现金及现金等价物	5,766,749	4,989,501	6,423,866

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

张素心(董事长)

唐均君(总裁)

非执行董事

叶峻

孙国栋

周利民

熊承艳

独立非执行董事

张祖同

王桂坝太平绅士

封松林

承董事会命

华虹半导体有限公司

张素心

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二四年十一月七日